

LDW-X6无掩模直写光刻设备

——130nm节点制版光刻设备



HIGH PERFORMANCE,
MASKLESS LITHOGRAPHY TOOLS

LDW-X6无掩模直写光刻设备

——130nm节点制版光刻设备

HIGH PERFORMANCE,
MASKLESS LITHOGRAPHY TOOLS

LDW-X6无掩模直写光刻设备是由合肥芯基微电子装备有限公司自主研发生产的一款高端光刻设备，该设备可以满足130nm节点的掩模版制造需求，同时应用于多种微纳加工领域。

主要功能及特征

器件无掩模直写光刻功能

光掩模版制作功能

3D结构曝光功能

自动对准功能

用户自定义标记对准功能

可视化定点曝光功能

自动实时聚焦功能

2种曝光方式、多物镜成像系统*选配

405nm LD激光器

支持多种数据输入格式 (DXF/ClF/GDSII/Gerber*选配/BMP/TIFF)

基于Windows系统，用户界面简单，易于操作使用

高精度气浮运动定位系统

高精度的环境控制系统



应用领域

MEMS

掩模版制作

IC器件

生物芯片

3D光刻

微传感器

微流体控件

关键技术指标

LDW-X6			
Item	Unit	I	II
支持最大基板尺寸	[inch]	6 inch	
最大曝光面积	[mm ²]	150X150	
最小解析	[μm]	0.5	1.0
数据网格精度	[nm]	15	25
线宽均匀性	[3σ,nm]	70	100
图形绝对位置精度	[3σ,nm]	80	110
套刻对准精度	[3σ/nm]	150	
产能	[mm ² /min]	150	300
环境控制	[NA]	22 ± 0.05°C (class 1~10)	